

1826 Mark 5 -回流焊炉系统

世界上最好的热风对流回流焊炉

在尽量减少预防性维护和占地面积的同时，提供一致的性能，以满足高容量要求。



- 无铅应用
- 简易维护保养
- 节能省氮
- [标配 Cpk 软件](#)

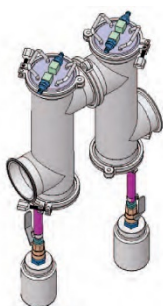
Mark 5 系列回流焊炉的出现，带来更低的使用成本。Heller 回流焊炉在加热和冷却方面的发展，可以为您节省高达 40% 的耗氮量和耗电量。MK5 系列不仅是最佳的回流焊系统，更具有业内最好的综合价值！

为您的利益而创新。

Heller 发明了第一套无水/无过滤助焊剂收集系统，并因此获得业界著名的 Vision 创新奖。但更重要的是，这个发明使得维护保养周期从几周延长到数月。能量管理方面的其他突破有利于 Heller 的客户在保持其可持续性指导方针的同时，做到对环境保护负责。

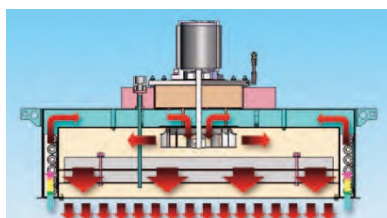
Mark 5 系列 SMT 回流系统的特征和优势

新冷却管式免维护助焊剂收集系统



我们的新冷却管式免维护助焊剂收集系统将助焊剂收集到收集罐中，而该收集罐能够在焊炉运行的同时被轻易移出和替换—因此，缩短了耗时的预防性维护。此外，我们专有的无助焊剂网孔板系统能够限制冷却网孔板上助焊剂的残留量—因此，不仅能够缩短维护时间，还能够争取生产时间—使得 Heller 系统享有比其他任何焊炉更高的生产率！

加强型加热模组



加强型加热器模块配置了 40% 的较大叶轮，为 PCB 提供放热保护，从而在最坚固的面板上实现最低的 ΔT_s ！此外，均衡气体管理系统去除了净流，因此，最多可以减少 40% 的耗氮量。

Profile 一步到位



通过与 KIC 合作研发的 Profile 一步到位，您仅输入您 PCB 的长度、宽度和重量，就能立刻对剖面进行设置。海量的温度曲线和时时更新的焊膏数据库为您完成其余的工作！

最快的冷却速率

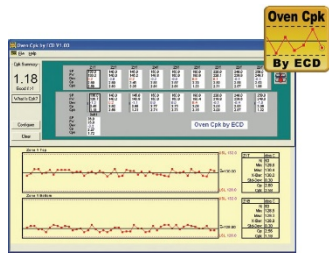


新 Blow Thru 冷却模组可提供 $>30^\circ\text{C}/\text{秒}$ 的冷却率，甚至是在 LGA 775 上也可以实现上述冷却率。该冷却率满足最严格无铅曲线要求。

ECD 提供的这种创新软件包提供了三种等级的工艺控制，即，焊炉 CpK、工艺 CpK 和产

节能软件—Heller 独有！

品可追溯性。这种软件确保了对所有的参数进行优化，并快速方便的报告 SPC



专用软件使您能对不同生产时段状况（产能大、产能一般、待机状态）时的排风量进行调控，使能源消耗最低。

